

FUJITSU PLMソリューション

良品解析事例（Agワイヤ使用ICのパッケージ開封）

概要

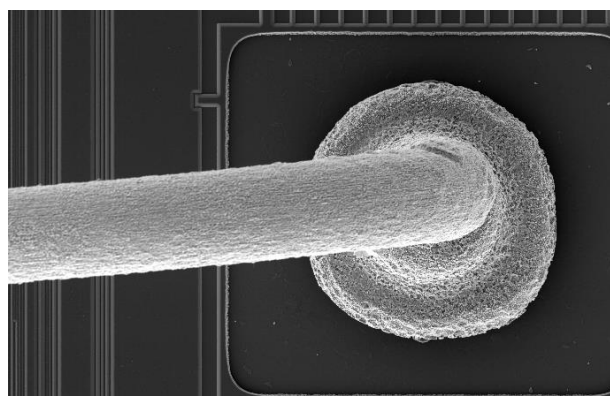
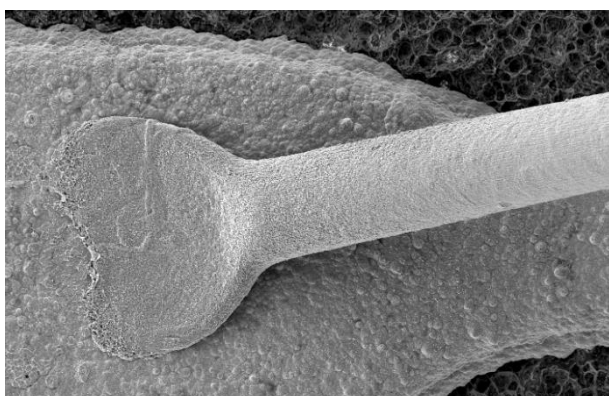
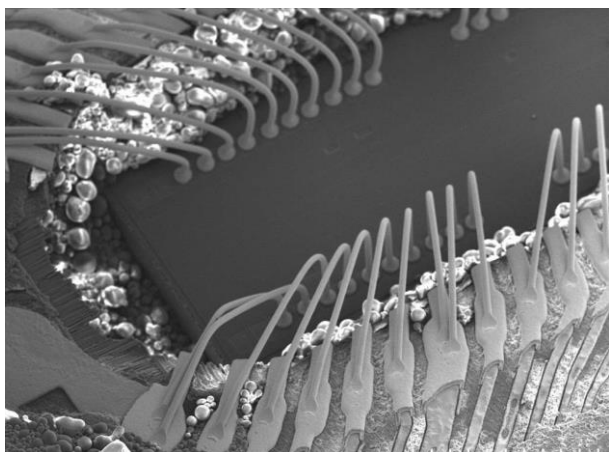
Agワイヤ使用ICの樹脂除去においては、ワイヤの薬品ダメージが大きいことが問題となります。当社では、飽和法[※]の原理を用い、ダメージを抑えたパッケージ開封方法の開発により、ボンディング形状の観察を可能といたしました。下記にご紹介いたします。

特徴

ワイヤ表面の観察、ボンディング状態の確認、エミッション観察の通電など、目的に合わせたパッケージ開封を行います。

（開封後のワイヤの状態は、樹脂種、ワイヤ種、形状等により程度が異なりますので、事前トライアルをお勧めしております。）

樹脂除去後のワイヤ状態



※) 日本サイエンティフィック株式会社様の飽和法による。

名称		対象部品、内容	関連設備、他
品質保証サポート		<p>製品開発におけるすべての工程で、品質に関するトータルなサポートが可能です。</p> <p>製品企画 → 部材選定 → 設計 → 試作評価 → 量産製造 → 出荷試験 → 市場品質 → 品質改善 → 評価基準</p> <p>部品調達先、ODM/OEM品質管理体制確認、診断、改善、構築支援、製造プロセス管理体制診断、改善 品質改善コンサルティング（監査、品質システム改善、部品認定、問題対応、評価基準作成等）、品質管理教育 設計プロセスコンサルティング、認証コンサルティング（海外環境、労働安全、ISO）、含有規制物質管理、 コンサルティング、計量計測機器校正管理</p>	
信頼性	故障解析	<p>半導体部品（LSI、メモリ、LED、MEMS、Tr 他） センサ部品（加速度、結露、ジャイロ、CCD 他） モジュール部品（DIMM、SSD、W-LAN、TVチューナ 他） 回路部品（抵抗、コンデンサ、コイル 他） 機構部品（コネクタ、プリント基板、ケーブル 他） ユニット部品（LCD、タッチパネル、キーボード 他） 電源系部品（電源、ACアダプタ、バッテリー 他） ファイル装置（HDD、BD/DVD/CD 他） ODM/OEM製品 上記部品の故障解析、及び対策立案 ・個別作業（IC樹脂開封のみ等）、期間契約もお受けします ・焼損原因解析もお問い合わせください</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・エミッション顕微鏡 ・X線装置（大型、高倍率、3D） ・FE-SEM、SEM、SIM ・レーザーオープナー ・チップ研磨機（CMP） ・ミリング装置 ・微分干渉顕微鏡 ・ファンクションジェネレータ ・ネットワークアナライザ（TDR） ・半導体パラメータアナライザ ・インピーダンスアナライザ ・絶縁抵抗計 ・ミリオームメーター ・高速度カメラ 他 ・OBIRCH ・超音波探傷装置 ・プラズマリアクタ ・フローバ ・汎用研磨機 ・FIB ・ROM評価システム ・カーブトレーサ ・輝度測定器 ・漏洩電流計 ・サーモグラフィ
	信頼性評価	<p>対象部品は上記と同一です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・信頼性試験項目全般（環境試験、寿命試験、問題対策提案） ・故障発生予測、再現実験（実使用シミュレーション） ・良品解析（技術調査、市場流通品出来栄確認、ODM/OEM製品の出来栄評価、品質リスク診断） ・実力評価 ・発煙/発火評価（電源、ACアダプタ、バッテリー等） 	<ul style="list-style-type: none"> ・熱衝撃試験槽（液槽、気槽） ・真空オープン ・耐候性試験機（カーボンアーク、スーパーキセノン） ・オイルディップ試験槽 ・マイグレーション試験機 ・微加振試験機 ・圧縮引張試験機 ・雷サージ試験器 ・蛍光X線分析装置 他 ・恒温恒湿槽 ・ガス腐食試験機 ・リフロー装置 ・連続データモニタ ・振動試験機 ・ESD試験器 ・ノイズシミュレータ
マテリアル	材料分析	<p>形態観察、表面分析、元素分析、成分分析、熱分析 加熱発生ガス分析、不良原因解明、コンサルティング 接着不良解析（原因究明から対策提案まで）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・TEM ・AFM ・u-XPS ・FT-IR ・FE-SEM ・SPM ・ICP-MS ・GC-MS ・FIB-SIM ・EPMA ・ICP-AES ・他、各種分析装置 ・SEM-EDX ・AES ・IC
	カスタマイズ接着剤	<p>新規接着剤の開発 製造販売</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・DSC ・粘度計 ・その他モデル実験用装置 ・TGA ・接着強度測定機 ・DMS ・TMA
	半田ペースト	<p>SnBi系低温はんだペーストの開発、販売</p>	
コンサルティング	ソフトウェア開発 プロセス診断、改善	<p>プロセス改善コンサルティング（CMMI®、AutomotiveSPICE®）</p>	
環境	<ul style="list-style-type: none"> ■ 水質/底質、大気/悪臭、騒音/振動の測定と分析 ■ 微小粒子状物質PM2.5の測定と分析 ■ 常時監視システムの開発、計測器保守 ■ 環境アセスメント ■ 自然環境調査（植物、動物、水生生物、生態系） 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 含有規制化学物質の法規制に関する分析サービス ■ 腐食環境診断/対策 ■ 土壌/地下水汚染の調査/対策 ■ 作業環境測定/対策（労働安全衛生法、作業環境測定法に基づく） 	

富士通クオリティ・ラボ株式会社

品質保証サポート、故障解析、信頼性評価

Tel : 044-280-9948

URL : <http://www.fujitsu.com/jp/group/fql/contact/evaluation/>

E-mail : fql-evaluation@cs.jp.fujitsu.com